

PRESSEMITTEILUNG

Neue Die-Attach-Klebstoffe für Chips / DELO präsentiert auf ECTC neue Lösungen für die Halbleiterindustrie

Windach, 26. Mai 2009: DELO Industrie Klebstoffe, Windach, präsentiert auf der Halbleitermesse ECTC (Electronic Components and Technology Conference) vom 26.-29. Mai 2009 in San Diego neu entwickelte Die-Attach-Klebstoffe für das Halbleiter-Packaging.

Die neuen lösungsmittelfreien Klebstoffe sorgen dafür, dass empfindliche Chips im Leadframe Package zuverlässig bei hohen Temperaturen fixiert werden. Denn die Anforderungen an Chip-Packages steigen: Wird das Chip-Package bleifrei gelötet, treten hohe Temperaturen von bis zu +260°C auf. Das heißt, der Klebstoff muss diesen hohen Temperaturen kurzfristig standhalten. Darüber hinaus werden die Chip-Packages immer kleiner und müssen gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Umfangreiche Die-Shear-Tests in den DELO-Labors bestätigen, dass die Produkte von DELO auch bei Lagerung von 168 Stunden bei 85°C/85% r. h. und einer anschließenden Simulation eines Löttests mit Temperaturen bis zu 260°C zuverlässig den Chip fixieren.

Die einkomponentigen MONOPOX-Chipklebstoffe von DELO sind für verschiedene Chipgrößen geeignet und daher sehr flexibel einsetzbar, insbesondere bei temperatur- und stressempfindlichen Anwendungsfällen. Denkbar ist ihr Einsatz zum Beispiel in Sensoren, Signalprozessoren oder etwa Steuerchips.

Ein weiterer Vorteil ist die sehr schnelle Aushärtung. Dadurch kommt es zu kürzeren Taktzeiten sowie einer Senkung der Prozesskosten. Zu den weiteren Vorteilen gehört die sehr geringe Wasseraufnahme der Klebstoffe, die gute Dosierbarkeit sowie eine lange Verarbeitungsdauer in der Produktion.

Weitere Informationen sowie eine kostenlose Broschüre zu „Die Attach Solutions“ gibt es per E-Mail unter: marcom@DELO.de

Über DELO:

DELO ist ein führender Hersteller von Industrieklebstoffen mit Sitz in Windach bei München. Im Geschäftsjahr 2008/09 erwirtschafteten 230 Mitarbeiter einen Umsatz von 30 Mio. Euro. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Spezialklebstoffe und Gerätesysteme für Anwendungen in speziellen Branchen – von der Elektronik bis hin zur Chipkarten- und Automobilzulieferindustrie sowie in der Glas- und Kunststoffverarbeitung. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Bosch, Daimler, Festo, Infineon, NXP und Siemens. DELO verfügt über ein Netz weltweiter Vertretungen und Vertriebspartner.

Pressekontakt:

Jennifer Bader
DELO Industrie Klebstoffe
DELO-Allee 1, 86949 Windach, Deutschland
Telefon +49 8193 9900-212
Telefax +49 8193 9900-5212
E-Mail jennifer.bader@DELO.de www.DELO.de

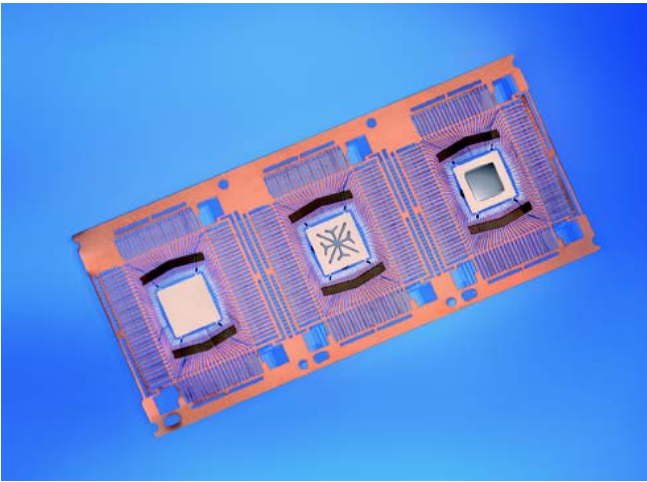


Abb. 1: Neue Die-Attach-Klebstoffe für die Halbleiterindustrie

Hinweis für Journalisten: Wünschen Sie Fotos in Druckauflösung?
Dann kontaktieren Sie uns: jennifer.bader@DELO.de